

出展製品のご案内

パワー半導体検査システム

世界一のパワー検査装置メーカーを目指します

パワー半導体ウェーハ検査システム SCV8W+WS58V2H

- SCV8Wはディスクリートからインテリジェントデバイスまで、ボリュームゾーンを1台でカバーできるシステムです。またWS58Vとの組み合わせによりウェーハ両面にコンタクトさせる構造で従来のプローバでは不可能だったパワーMOSFETなどの大電流試験を可能にしました。

○±64V/±160mA ±32V/±320mA

○+2000V /±20mA

○±16V/±100A

○±60V/±10A、±30V/±30A

○±128V/±250mA、±40V/±5A

- WS58V2H 高温・大電流プローバ

○薄厚ウェーハ 8インチ60 μ mを実現

○超高精度、低ON抵抗測定 (1m Ω /200Aの測定可能)

○動特性測定 SW (L負荷)、アバランシェ耐量、
Qg、di/dt、Trr、Qrr

○高温オプション 室温~175 $^{\circ}$ C



SCV8W



WS58V2H

(株)みくに工業 製
(株)シバソク 共同企画システム販売

パワー半導体チップ検査システム SCV66/WL25MV+WS67

- SCV66シリーズは小ピンディスクリートから汎用ICまでカバーし、コンパクト設計、コストパフォーマンスの高いプラットフォームを提供いたします。

- WL25MVは8マルチステージの同品種、異製品の異テスト項目の8同時測定(動特性測定/静特性測定)を実現しWL25MV 1台のMP Windowでデータの集中管理・制御などの機能を搭載。また、特許第4558601号の保護回路によって安定(デバイス、装置などの破壊を阻止)した開発・生産を実現可能にしている。

○静特性測定モジュール：大電流2400A/16V (パルス幅10ms max) 開発中高電圧モジュール、Vth専用モジュール

○動特性測定モジュール：スイッチング (L負荷、R負荷)、波形解析、短絡試験
アバランシェ耐量、Qg、di/dt、Trr、Qrr、過渡熱試験

- WS67チップハンドラ

○印加電流：600A、耐電圧：2000V、チップサイズ□3.0mm~□17mm
チップ厚70 μ m~360 μ m可能。

○動特性測定：スイッチング (L負荷)、アバランシェ耐量、Qg、di/dt、Trr、Qrr、



SCV66



WL25MV



WS67

ShibaSoku

(株)オプトシステム社 製
(株)シバソク 共同企画システム販売



The elements of innovation

SEMICON[®] Japan2011

12月7日(水)～9日(金) 幕張メッセ
ブースNo.7A-309でお待ちしております。

株式会社シバソク

<http://www.shibasoku.co.jp/>

ごあいさつ

お客様各位

拝啓

貴社ますますご盛栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のお引き立てを賜り厚くお礼申し上げます。

弊社は、来る12月7日(水)から幕張メッセにて開催される「**セミコンジャパン2011**」にパワー半導体において、ウェーハテストからモジュールテストまで、システムを中心に展覧いたします。(ブースNo7A-309、7ホール)

省エネ・低炭素社会に向けた新技術開発への世界的な取り組みが進むなか、コンシューマ・産業用機器を問わずパワー半導体の需要は増すばかりです。これら進化・拡大を続けるマーケットに向けて、パワー半導体のテストソリューションとして、システムでのご提案します。

ご多忙の中大変恐縮ではございますが、万障お繰り合わせの上ご来場賜りますようご案内申し上げます。

敬具

平成23年11月吉日
株式会社 シバソク
代表取締役社長兼C.E.O.
重崎 高至